



<b>Title of Change:</b>	ASESH Epoxy changed from YIZBOND 8143 to CRM-1076WA for LQFP Package.			
<b>Proposed First Ship date:</b>	14 January 2019			
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <keiji.ueda@onsemi.com>			
<b>Samples:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.			
<b>Type of Notification:</b>	<p>This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. IPCNs are typically issued 30 days prior to the issuance of the Final Change Notice (FPCN). An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan.</p> <p>The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact &lt;PCN.Support@onsemi.com&gt;</p>			
<b>Change Part Identification:</b>	Product material with date code after qualification completion will be built with noted change.			
<b>Change Category:</b>	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____			
<b>Change Sub-Category(s):</b>	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____			
<b>Sites Affected:</b>	ON Semiconductor Sites: None	External Foundry/Subcon Sites: ASE Shanghai		
<b>Description and Purpose:</b>				
ASESH Epoxy changed from YIZBOND 8143 to CRM-1076WA for LQFP Package. The change is due to YIZBOND-8143's supplier announce for closure.				
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>		
Die Attach	YIZBOND-8143	CRM-1076WA		
There is no product marking change as a result of this change				
<b>Qualification Plan:</b>				
<b>Test</b>	<b>Specification</b>	<b>Condition</b>	<b>Interval</b>	<b>Sample size</b>
TC	JESD22-A104	Ta= - 65°C to + 150°C	500 cyc	80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 260 °C		
Estimated date for qualification completion: 30 November 2018				
<b>List of Affected Parts:</b>				
<b>Part Number</b>		<b>Qualification Vehicle</b>		
LC821621-E		LC821621-E		

**NOTE:** Please be informed that there are Customer Specific parts impacted by this notice, thus MPN & CPN info will not be reflected in the parts list of this Generic document. Instead please click the link to the addendum copy provided in the email notification to see full list of affected products specific to your company.

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22444X

発行日 : 16 September 2018

変更件名:	ASESH の LQFP パッケージ用エポキシの YIZBOND-8143 から CRM-1076WA への変更																						
初回出荷予定日:	2019 年 1 月 14 日																						
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <keiji.ueda@onsemi.com> にお問い合わせください。																						
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、今回の変更の初回通知、初回 PCN、または最終 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。																						
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、通常、最終変更通知 (FPCN) の発行の 30 日前に発行されます。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。最終版の認証データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だてて通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。																						
変更部品の識別:	認定終了後の日付コードの付いた製品は変更通知された材料で作られています。																						
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____																						
変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他 : _____																						
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場 / 下請け業者拠点: ASE Shanghai																					
説明および目的:	ASESH の LQFP パッケージ用エポキシを YIZBOND-8143 から CRM-1076WA へ変更します。この変更は YIZBOND-8143 のサプライヤからの供給停止通知に基づくものです。																						
		変更前の表記	変更後の表記																				
	ダイ接着剤	YIZBOND-8143	CRM-1076WA																				
今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。																							
認証計画:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>試験</th> <th>仕様</th> <th>条件</th> <th>間隔</th> <th>サンプルサイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TC</td> <td>JESD22-A104</td> <td>Ta = - 65°C to + 150°C</td> <td>500 cyc</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>uHAST</td> <td>JESD22-A118</td> <td>130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased</td> <td>96 hrs</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>PC</td> <td>J-STD-020 JESD-A113</td> <td>MSL 4 @ 260 °C</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			試験	仕様	条件	間隔	サンプルサイズ	TC	JESD22-A104	Ta = - 65°C to + 150°C	500 cyc	80	uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	80	PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 260 °C		
試験	仕様	条件	間隔	サンプルサイズ																			
TC	JESD22-A104	Ta = - 65°C to + 150°C	500 cyc	80																			
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	80																			
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 260 °C																					
認定完了予定日: 2018 年 11 月 30 日																							
影響を受ける部品の一覧:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品番号</th> <th>認証車両</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC821621-E</td> <td>LC821621-E</td> </tr> </tbody> </table>			部品番号	認証車両	LC821621-E	LC821621-E																
部品番号	認証車両																						
LC821621-E	LC821621-E																						

注: 本通知により影響を受ける顧客特定部品があり、よって MPN および CPN 情報は本一般文書の部品リストに反映していないことにご留意ください。代わりに、特に御社に影響する製品の全リストを見るためには電子メール通知で提供される補遺コピーへのリンクをクリックしてください。



---

## Appendix A: Changed Products

---

D

---

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle
LC821621-E		LC821621-E